

中信证券股份有限公司
关于
宝鼎科技股份有限公司调整部分募投项目
投资规模并永久补充流动资金
之
专项核查意见

独立财务顾问



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

签署日期：2024年8月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝鼎科技调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金相关事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、调整部分募集资金规模的概述

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

2022年8月23日，上市公司公告收到中国证券监督管理委员会《关于核准宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]1862号），获准向招金有色矿业有限公司发行股份募集配套资金不超过3亿元。2022年9月23日，中信证券将扣除承销服务费后的认购款项的剩余款项划转至上市公司指定账户中。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月23日出具的《验资报告》（中天运[2022]验字第90052号），截至2022年9月23日止，本次募集资金总额人民币299,999,994.84元，扣除各项不含税发行费用13,911,972.06元，募集资金净额为286,088,022.78元。扣除承销费用（含增值税）14,000,000.00元后，公司实际收到募集资金为人民币285,999,994.84元。

（二）募集资金投资项目情况

根据《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集资金投资项目原拟用于投入标的公司“7,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项目”、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用等。

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	占配套融资总额的比例	募集配套资金金额占交易总金额的比例
1	7,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项目	25,000.00	83.33%	17.04%

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	占配套融资总额的比例	募集配套资金金额占交易总金额的比例
2	补充上市公司流动资金及支付中介机构费用	5,000.00	16.67%	3.41%
合计		30,000.00	100.00%	20.45%

二、本次调整部分募集资金规模的相关情况

（一）原募投项目计划和实际投资情况

项目名称	7,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项目
实施主体	山东金宝电子有限公司
实施地点	山东省烟台市招远市开发区金晖路229号
项目总投资规模	66,567.99万元
募集资金承诺投资金额	25,000.00万元
具体建设内容	厂房厂区建设、设备购置及安装、铺底流动资金
实施方式	新建
截至2024年6月30日，已使用募集资金金额	10,016.95万元(含利息收入17万元)
项目达到预定可使用状态的时间	2024年12月

（二）本次调减项目总投资规模的情况

根据项目可行性研究报告，本次调减“7,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项目（即募投项目）”投资规模，由年产7,000吨调减为年产2,000吨，项目总投资由66,567.99万元调减为25,700.00万元，其中募集资金投入由25,000.00万元调减为18,000.00万元，其余7,700.00万元为自筹资金。募投项目投资规模调整前后对比情况如下：

单位：万元

调整前					调整后				
项目名称	总投资	募集资金拟投资总额	累计已投入募集资金总额	剩余募投资金总额	项目名称	总投资	募集资金拟投资总额	累计已投入募集资金总额	剩余募投资金总额

7,000 吨/ 年高速高 频板 5G 用 (HVLP) 铜箔项目	66,567.9 9	25,000.0 0	9,999.95	15,000.05	2,000 吨/ 年高速高 频板 5G 用 (HVLP) 铜箔项目	25,700.0 0	18,000.0 0	9,999.95	8,000.05
--	---------------	---------------	----------	-----------	--	---------------	---------------	----------	----------

注：1、“累计已投入募集资金总额”为截至 2024 年 6 月 30 日的投入总额（不含利息收入）；
2、“剩余募投资金总额”不含利息收入和理财收益，未扣除银行手续费。

2021 年至 2023 年，国内新增电子铜箔产能分别为 11.3 万吨、41.2 万吨、54 万吨，产能增长 1.8 倍。与此同时产能利用率较低，2023 年国内电子铜箔总产能约为 167 万吨，总产量约为 94 万吨，产能利用率约为 56.3%，开工率严重不足。根据中国电子铜箔材料协会调查统计，2024 年预计仍有 68 万吨的在建产能计划要投产。铜箔产能的增长速度超出下游需求的增长速度，现阶段铜箔产能相对过剩。市场竞争激烈，铜箔加工费低于成本线，全行业进入微利或亏损状态。

针对现阶段电子铜箔产能过剩和下游电子行业需求疲软，为降低投资风险，提高资金利用率，公司根据市场变化情况，拟对募投资项目投资规模进行上述调整。公司拟将结余募集资金 7,000 万元及利息永久补充流动资金。公司调整募投资项目投资规模是根据国内外市场环境变化及公司发展规划作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率、降低投资风险，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。调减后结余募集资金永久补充公司流动资金，有利于进一步充盈公司现金流，改善财务状况和提升资产质量。

三、本次调整部分募集资金规模的影响

公司本次调整部分募集资金投资项目投资规模，符合公司实际情况和募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，能够尽快实现项目建设，保障公司持续发展，符合公司全体股东的利益。本次调整部分募集资金投资项目投资规模没有与募投项目的实施计划相抵触，并未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金使用计划及主要内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情形。

四、履行的审议程序

（一）内部审议程序

公司已于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：鉴于市场环境发生较大变化，根据《山东金宝电子有限公司 2000 吨/年高速高频板 5G 用（HVLP）铜箔项目可行性研究报告》，公司拟对“7,000 吨/年高速高频板 5G 用（HVLP）铜箔”募投项目投资规模进行调减，由年产 7,000 吨减少到 2,000 吨，项目总投资由 66,567.99 万元减少到 25,700.00 万元，其中募集资金投入由 25,000.00 万元减少到 18,000.00 万元，其余 7,700.00 万元为金宝电子自筹资金投入。公司拟将调减后结余募集资金 7,000.00 万元及利息永久补充流动资金。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目投资规模并拟将结余募集资金及利息永久补充流动资金，履行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问机构认为：宝鼎科技本次调整部分募集资金规模的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次调整部分募集资金规模是公司根据公司和募投项目实际实施情况做出的调整。综上，独立财务顾问对公司本次调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于宝鼎科技股份有限公司调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金之专项核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人

冯新征

张昕

张子晖

中信证券股份有限公司

2024年8月23日